

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

## 环旭电子股份有限公司 2026年第一季度投资人线上说明会活动记录

<b>投资者关系活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
<b>时间</b>	2026年4月28日
<b>地点</b>	线上会议（进门财经网络研讨会）
<b>上市公司 参会人员</b>	魏镇炎（总经理）、许远忠（子公司光创联 CEO）、史金鹏（董事会秘书）、吴新宇（财务长）
<b>参会机构名称</b>	摩根士丹利；摩根大通证券；瑞银证券；中金公司；信达证券；华泰证券；东北证券；西部证券；天风证券；国海证券；华创证券；广发证券；甬兴证券；浙商证券；民生加银基金；海富通基金；招商基金；鹏扬基金；国海富兰克林；交银施罗德基金；中信保诚基金；西部利得基金；百嘉基金；富国基金；嘉实基金；华宝基金；申万菱信基金；摩根基金(中国)；摩根士丹利基金；领久私募基金；深圳申量基金；宁波信石投资；福州川海私募；深圳旦思先锋；上海日胜隆私募；上海大朴资管；华美国际投资；前海云溪基金；深圳前海博普；健顺投资；上海驭乘投资；金之灏基金；山证上海资管；东方证券资管；北京人寿；野村国际证券；永丰证券；永灵通投资；摩根证券；华宝信托；陆家嘴信托；东方资产；世嘉控股；弘洛投资。
<b>嘉宾简报及投资者提问</b>	<p>一、公司2026年第一季度经营业绩情况（财务长吴新宇先生）</p> <p><b>【经营情况概述】</b></p> <p>2026年第一季度营业收入为133.5 亿元，较第四季度环比降幅14.2%，较去年同期同比降幅2.2%。营业收入同比下降主要受到WiFi模组物料采购成本下降带动产品降价的影响以及合并报表范围变化。</p> <p>第一季度营业利润率为3.6%，较去年同期的2.9%，同比增长0.7个百分点。第一季归母净</p>

利润为4.2亿元，归母净利润率为3.1%，较去年同期的2.5%，同比增长0.6个百分点。扣非后归母净利润为4.1亿元。受净利润、净资产同比增长的原因，ROE、ROA、EBITDA、EPS同比增长。经营活动保持稳定流入，因应付债券转股原因负债率较上年度下降。

#### 【营业收入】

第一季度实现营业收入为133.5亿元，较去年同期的136.5亿元，同比降幅2.2%，相较于第四季度155.5亿元，环比降幅14.2%。

因受市场需求及客户总体需求影响，各类产品营收同比呈现不同的增降幅度。

其中：

(1) 通讯类产品实现营收34.6亿元，同比降幅23.0%；主因及WiFi模组物料采购成本下降带动产品降价的影响；

(2) 消费电子类产品实现营收47.2亿元，同比增幅10.6%；主系子公司飞旭带来的一些增量及穿戴产品同比出货量增加，营业收入同比增加

(3) 工业类产品实现营收18.7亿元，同比增幅6.4%；主系本期新增订单等带来的收入成长所致。

(4) 云端及存储类产品实现营收20.6亿元，同比增幅44.5%；主系得益于AI智能卡出货量大幅成长，营业收入增长较快所致。

(5) 汽车电子类产品实现营收8.5亿元，同比降幅38.6%，主因公司合并范围变化，在去年第三季将间接持有的控股子公司环强电子出售所带来的收入减少，以及Powertrain本期收入较去年同期减少所致。

(6) 医疗类产品份额较小，实现营收1.3亿元，同比增幅40.9%。

#### 【营业毛利及营业毛利率】

第一季度实现营业毛利为12.6亿元，同比降幅1.8%，相较于第四季度环比降幅9.5%。

第一季度营业毛利率为9.5%，较去年同期9.4%，同比增长0.1个百分点，相较于四季的9.0%，环比增长0.5个百分点。

其中：

云端及存储类产品主系材料成涨价带来的不利影响，毛利率同比减少1.90个百分点；通讯类产品主系市场份额的同业竞争、客户产品结构的变化及产品价格带来的不利影响，毛利率同比减少0.84个百分点；消费电子类产品主系受人民币对美金升值对毛利带来的不利影响，毛利率同比减少0.39个百分点；汽车电子类产品主系公司合并范围变化，在去年第三季将间接

持有的控股子公司环强电子出售所带来的毛利率的减少，毛利率同比减少4.79个百分点。工业类产品主系产量上升带来的成本效益提高所致，毛利率同比增长2.52个百分点。

#### 【现金流量】

公司2026年第一季度现金流量为净流出27亿，其中：

经营活动产生的现金流2026年第一季度为净流入，较去年同期流入减少人民币2.9亿元，主系因客户订单需求变化，以及受材料供货紧张公司提前备料所致。

投资活动产生的现金流2026年第一季度为净流出，较去年同期流出增加人民币23.0亿元，主系因本期理财产品投资尚未到期赎回及收购境内公司股权所致。

筹资活动产生的现金流2026年第一季度为净流入，较去年同期流入增加人民币0.7亿元，主系因公司营运需求，短期借款较去年同期增加所致。

#### 【营运情况】

因受材料供货紧张公司提前备料所致，现金周转天数较去年同期增加3天。。

2026年第一季度末公司总资产、净资产有所增长，有息负债因可转换债券转股及赎回原因，较去年年底减少30.4%，资产负债率因可转换债券转股及赎回原因，本期较去年年底减少5.9个百分点。

2026年第一季度总资产收益率1.1%；加权平均净资产收益率为1.9%；每股收益为0.18元/股。

#### 【经营目标】

公司预计第二季度单季营业收入同比增长中个位数，第二季度单季营业利润率同比提高，预计恢复到2024年同期水平。

#### 二、服务器策略（总经理魏镇炎先生）

在服务器板卡的规划上，母公司在先进封装业务方面的客户有机会为USI带来更多的业务机会，在集团内部解决方案能力垂直整合的背景下，能够为CSP客户提供从芯片级封装到板卡级设计和制造的全方位服务。

在数据中心的业务上，服务器供电也是我们的布局重点。母公司日月光的powerSiP平台聚焦于垂直整合多级电压调节模块提升系统能效并降低功耗，目前环旭正与母公司合作成立「高压直流」HVDC实验室，该实验室重点研究高压直流输电在未来电力技术演进中的应用，包含从高压直流输电电源到ASIC供电和系统级验证，环旭重点负责PDU的协同研发和系统组装。

针对服务器板卡业务，受益于客户的需求持续提升，公司持续在产能扩充、智能制造和配合客户需求的生产据点布局上增加投资。产能规划方面，AI智能卡2025年Q4已达成90K的月产能，在2026年上半年扩充至180K的月产能，公司计划再增加一条产线，年末达成225K的月产能目标，这将构成支撑智能卡业务持续快速增长的基础。服务器主板方面，规划在墨西哥和台湾分别新增10K的月产能，整体月产能提升至60K，主要用于支持Hyperscaler与AI服务器导入所需的高复杂度主板产品。

2026年Q1，服务器业务收入同比增长约100%，其中尤以AI智能卡的业务增长贡献最大，主要受益于CSP客户需求的快速放量。公司预期全年服务器板卡业务的增速能够延续Q1的成长动能，营收成长部分原因是由于外购DRAM涨价的影响，具体影响幅度视DRAM后续价格变动情况而定。

关于PDU的业务进展，由于PDU是一个高度定制化的系统开发项目，目前公司已向客户首次提交mechanical sample，并计划在年底前完成第二次送样，并按照原计划于2027年完成产品验证和量产线的建制，具体生产计划将取决于客户项目的实际进展。环旭与母公司合作开发的PDU匹配的是TSMC SOW制程，项目开发周期较长，而针对当下数据中心服务器供电的需求，围绕供电单元PSU和垂直供电架构，公司也在和技术合作伙伴进行POC或方案开发，对接CSP厂商需求。

**【Q&A环节】**

**【问题】**公司ELSFP和DCI产品在客户验证上的进展如何？

**【回答】**ELSFP应用于CPO/NPO，DCI是指数据中心的互联，CPO和DCI都是光创联的核心产品方向。光创联ELSFP在今年3月完成首样，可以做到UHP 23dBm的版本，正在根据客户需求的情况（如不同波长等）优化设计方案，规划6月完成优化版本，目前已经与多家头部客户进行了对接并安排产品认证。DCI业务上，光创联已经可以量产400G和800G相关nano ITLA产品；DCI领域还有一种较低成本的400G ER4的方案，光创联已于2025年量产；此外，光创联也正在加速研发1.6T相干产品以完善高速互联的产品矩阵。

**【问题】**今年以来，市场上参与CPO的头部厂商增多，也分别与ASE和SPIL有互动，请问公司在CPO上与母公司的协同情况或者看到的业务机会如何？以及在技术储备上，有哪些开发进展以及难点？

**【回答】**公司在NPO和CPO上都会做技术储备和支持，目前看到CPO量产还有几个难点，包括：1）前端的EIC、PIC的封装集成和RDL等，这部分会封测端会有解决方案；2）detachable

FAU的设计以及多通道耦合技术，由于CPO涉及多达几十个通道的FAU耦合，这是CPO量产的核心难点之一；3）CPO产品的自动化和测试工艺，目前工艺的结合以及成本还存在难点。

对于光创联来说，CPO方面有一定技术积累。在早期COBO协议上2019年就有产品推出800G COBO样品，后续协议虽演进到CPO，但底层技术逻辑得以延续。光创联选择加入环旭电子，是看到了有机会结合日月光集团先进封装技术，补足光学集成封装能力，占据下一代CPO产品的领先技术及市场地位。光创联在CPO具体产品开发的策略是，支持客户开放式光学集成方案的需求。同时区别于行业内跟从单一芯片厂家在供应链上封闭局面，公司将在ASE现有先进封装能力的基础上，进一步解决后续光学工艺，以及D-FAU的耦合封装及光电测试，致力于打造开放化、定制化光学集成方案。

此外，公司还致力于的一个重要环节是光电集成封装及光电测试一体化的设备的开发，来适应公司自身量产工艺的方案，也会协同ASE先进封装的工艺资源，完成功能和框架设计，目前已经有了初步设计方案。

透过和ASE的合作，公司希望能够提供更多的开放式的一个服务模式，能够为不同的技术路线都能够提供CPO的方案。除了TSMC的COUPE平台，市场也出现了不同的CPO的平台方案来寻求ASE的技术支持与合作，当下就是一个很好的切入口，针对头部厂商的技术路线，随着公司CPO上的能力提升，相信后续会有更多机会与集团协同服务头部厂商。

CPO是下一代光互联技术主流发展方向，从光创联到环旭电子再到日月光集团，已启动CPO业务协同战略规划，从芯片封测到D-FAU组装，到ESLFP光源、交换机组装，提供端到端解决方案。

**【问题】**公司越南产能的落地进展？2026及2027年光模块出货预期如何？

**【回答】**光创联在成都都是基于全系列的COB的技术产线，自2026年2月在成都扩产4000m<sup>2</sup>生产场地，预计五月可以验收并投入使用，届时100-400G的光引擎产能为10万只/月，800G-1.6T的产能可达4万只/月，后续根据客户需求进一步推进扩产计划。

越南方面，6月底之前，能够形成1万只/月的光引擎产能，看到北美客户的需求相对旺盛，希望扩产进度加快，并在Q3完成15万只/月的光引擎产能。目前产线上的一些核心设备，如自动耦合设备等，是公司自主开发的，设备交期相对可控，进一步的扩产计划也正在和几家头部的海外客户讨论。目前越南已规划的15万只/月光引擎以及10万只/月光模块组装测试的能力，占用了预留生产面积的一半空间，未来公司还有能力在该基础上扩充一倍的产能。在涉及光模块组装和测试的部分，尤其后端测试设备具有一定的交期，10万只/月光模块的组装测

试会不断构建起来，相信产能形成后，随着客户对产线的认证完成，产能会得到充分利用。

**【问题】** Q2不同业务类型哪些成长较快，哪些乏力？AI眼镜营收预期如何，哪个季度开始放量？

**【回答】** 云端存储业务受益于智能卡快速成长，二季度依然会保持较高增速；AI眼镜SiP模组业务也会在二季度开始放量，全年预估能达到整体SiP业务营收10%的水准；工业类产品的需求今年也看到了一定回升，毛利率也有一定提高。相对而言，消费电子产品通常第二季度都是淡季，环比会有下降；通讯类产品同比也会有一些下降。综合来看，二季度会有一个中个位数的营收成长。

**【问题】** 此前公司在OFC上与北美客户的交流情况如何？是否有新的客户接洽？1.6T产品送样的进展如何？

**【回答】** 本次OFC展会上，公司重点展示了800G、1.6T光互联产品、ELSFP以及用于DCI的nITLA产品，和不少北美客户进行了深度技术交流，覆盖了前述产品以及CPO产品的开发以及光计算领域的应用，与三家头部的光互连公司以及两家光计算的头部公司建立了稳固的对接机制，会持续跟进技术交流和定制化的产品开发。公司预计在pluggable的产品上进展会更快，同步也会推进光计算领域客户的CPO量产协同，早期的介入相关领域对公司未来发展还是更有利的。

关于1.6T光模块的进展，目前正在优化前端光引擎的设计，在firmware开发层面也在增强自身能力，此外还要在供应链端进行协调做好安排，2026年最主要的还是做好800G产品从光引擎到光模块的代工业务。

**【问题】** 存储价格提升对大客户的产品影响情况如何？

**【回答】** 存储涨价对中低端的产品影响会更大一些，2026年公司在通讯类和消费电子类的产品上还是会看到一些压力，尤其是通讯类的产品；因此2026年营收可能会有一定下滑，整体幅度可能超过10%，由于下半年是传统出货旺季，具体情况要看下半年客户实际订单情况。目前对2027年的展望上，预计会恢复到2025年的一个出货和营收规模水平。

**【问题】** 公司智能卡的需求强劲，除了特定csp客户以外，是否还有其他客户在接洽？

**【回答】** 除了既有客户订单快速增长之外，目前还有一些客户在接洽中，订单量还不是很大，但就算力板卡的业务和集团的协同上来看，未来会有机会透过ASE的先进制程，为公司业务争取更多的成长机会，公司将有机会参与一些先进制程产品的前期研发，通过这个模式在算力板卡业务层面实现先发优势。

附件清单（如有）	无
日期	2026年4月28日